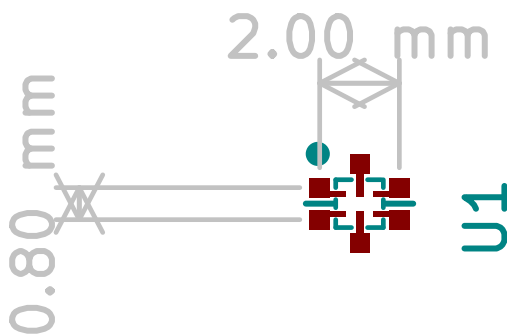
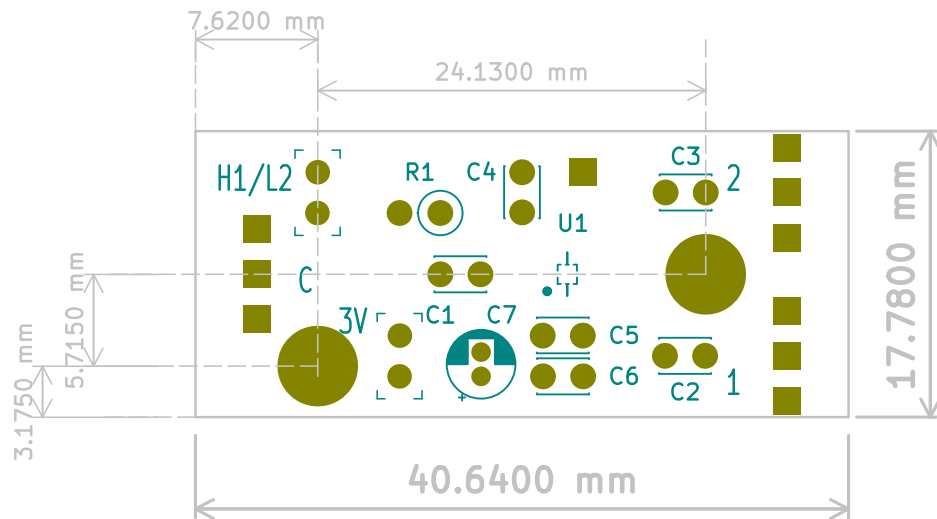


本書はハムフェア 2023 で頒布した RF SW 基板に関する説明となる

使用している IC は小さいので覚悟が必要（付けられるか検証が目的の基板、手半田できること確認）

ディスクリート部品を使っているので 430M まで（ランド間に半田するなら 1608 を使用可）

H1/L2 が制御信号で 3V(3.3V)だと 1 側と接続（電源を含め 5V 不可なので注意）



左図はハンダゴテを当てる先の中心からの寸法

デバイス(IC)自体は 1mm 角しかない

外側に配置したパッドから熱を伝えて半田

コテ先は D 型を使いパッドに熱を伝える

入力ピンの半田付けで正しい位置になるよう決める

IC 側はシルクがあるので並んだところは同時半田も可

目視で状態を判断するのは無理

